

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月6日

【会社名】 株式会社RS Technologies

【英訳名】 RS Technologies Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 方 永義

【本店の所在の場所】 東京都品川区大井一丁目47番1号

【電話番号】 03(5709)7685(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 正行

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目47番1号

【電話番号】 03(5709)7685(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 正行

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

一般募集	8,874,585,000円
引受人の買取引受けによる売出し	3,037,536,000円
オーバーアロットメントによる売出し	1,846,944,000円

(注)1 募集金額は、発行価額の総額であり、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

2 売出金額は、売出価額の総額であり、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】

- 1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
- 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	1,220,000株	完全議決権株式であり、株主の権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1 平成30年3月6日(火)開催の取締役会決議によります。

- 2 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、242,000株を上限として、一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主である方永義(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。これに関連して、当社は平成30年3月6日(火)開催の取締役会において、一般募集とは別に、株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当による当社普通株式242,000株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 第三者割当増資について」をご参照ください。

- 3 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照ください。

- 4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

2 【株式募集の方法及び条件】

平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

(1) 【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当			
一般募集	1,220,000株	8,874,585,000	4,437,292,500
計(総発行株式)	1,220,000株	8,874,585,000	4,437,292,500

(注) 1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

- 2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。

- 4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2) 【募集の条件】

発行価格(円)	発行価額(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注) 1、2 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件とします。	未定 (注) 1、2	未定 (注) 1	100株	自 平成30年3月16日(金) 至 平成30年3月19日(月) (注) 3	1株につき発行価格と同一の金額	平成30年3月26日(月) (注) 3

(注) 1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状況等を勘案した上で、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額)であり、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金に対する払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1) 募集の方法」に記載の一般募集における新株式発行の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <http://www.rs-tec.jp/>)(以下「新聞等」という。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の通り、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成30年3月9日(金)から平成30年3月15日(木)までとしておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までを予定しております。

したがって、

発行価格等決定日が平成30年3月13日(火)の場合、申込期間は「自 平成30年3月14日(水) 至 平成30年3月15日(木)」、払込期日は「平成30年3月22日(木)」

発行価格等決定日が平成30年3月14日(水)の場合、申込期間は「自 平成30年3月15日(木) 至 平成30年3月16日(金)」、払込期日は「平成30年3月23日(金)」

発行価格等決定日が平成30年3月15日(木)の場合、上記申込期間及び払込期日の通りとなりますので、ご注意ください。

4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

5 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金にそれぞれ振替充当します。

6 申込証拠金には、利息をつけません。

7 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがって、

発行価格等決定日が平成30年3月13日(火)の場合、受渡期日は「平成30年3月23日(金)」

発行価格等決定日が平成30年3月14日(水)の場合、受渡期日は「平成30年3月26日(月)」

発行価格等決定日が平成30年3月15日(木)の場合、受渡期日は「平成30年3月27日(火)」

となりますので、ご注意ください。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

(3) 【申込取扱場所】

後記「3 株式の引受け」欄記載の引受人の本店及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 五反田支店	東京都品川区東五反田一丁目14番10号

(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

3 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	572,700株	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金となります。 4 引受人は、上記引受株式数のうち一部を、引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
SMB C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	372,100株	
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号	194,200株	
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号	32,400株	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	32,400株	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号	16,200株	
計		1,220,000株	

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
8,874,585,000	52,940,000	8,821,645,000

(注) 1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

2 払込金額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額8,821,645,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限1,751,748,500円と合わせた手取概算額合計上限10,573,393,500円について、当社が中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金として4,200,000千円を充当、当社の中国の合弁会社へ増資するための資金として2,800,000千円を充当します。残額の3,573,393千円については、ウェーハ増産に係る設備投資資金として、三本木工場に400,000千円、台湾工場に700,000千円、北京工場に2,473,393千円をそれぞれ充当します。

上記の北京有研RS半導体科技有限公司へ出資した借入金および出資資金の目的としましては、成長性が高いと考える中国の半導体市場に参入するためであります。当社としては、成長性が高いと考える中国の半導体市場に参入するために有力なパートナーと提携し、プライムウェーハ製造販売事業への展開を図るというニーズがありました。一方で、北京有色金属研究総院としては当社のマネジメント力、ウェーハ加工技術を活かし、今後成長する中国の半導体市場において、プレゼンスを握りたいというニーズがありました。両社のメリットについて協議した結果、この度2018年1月に北京有色金属研究総院及び中国現地投資会社である福建倉元投資有限公司と三社間で合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司を新設し、それに伴い北京有色金属研究総院の100%子会社である有研半導体材料有限公司を連結子会社化し中国の半導体市場参入を実現しました。

ウェーハ増産の経緯としましては、当社グループの主要な事業であるシリコンウェーハ再生事業(半導体製造過程で発生するモニタウェーハ(1)の再生を行う事業)において、新興国の経済発展及び先進国の更なるデバイス用途(車・医療・環境・家・町・データセンター・IoT・M2M(2))の広がり等を背景とした半導体需要が拡大していることによるものであります。

上記調達資金の充当時期につきましては以下を予定しておりますが、具体的な支払が発生するまでは安全性の高い銀行預金等により資金管理を図る予定です。

- 1 モニタウェーハ：半導体製造過程のモニタリングを実施するために使用するウェーハ。
- 2 M2M：Machine to Machine(マシン・ツー・マシンの)省略形で、機器間の通信を意味しております。

(単位：千円)

項 目	予定金額	支払予定時期		
		平成30年12月期	平成31年12月期	平成32年12月期
借入金の返済資金	4,200,000	4,200,000		
中国の合弁会社への出資資金	2,800,000		1,750,000	1,050,000
ウェーハ増産に係る設備投資資金	3,573,393		3,573,393	
調達による充当額合計	10,573,393	4,200,000	5,323,393	1,050,000

上記ウェーハ増産に係る設備投資資金3,573,393千円の内訳は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在(ただし、既支払額については平成30年1月31日現在)、以下のとおりとなっております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月	
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
艾爾斯半導體 股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
有研半導体材 料有限公司	北京工場 (中華人民共和 国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェー ハ製造設備	2,473,393		増資資金	平成31年 1月	平成32年 1月

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

第2 【売出要項】

1 【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】

平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される引受価額にて後記「2 売出しの条件」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数	売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	398,000株	3,037,536,000	東京都品川区 方 永義 279,000株
			東京都品川区 李 宗根 50,000株
			東京都中野区 本郷 邦夫 20,000株
			千葉県鎌ヶ谷市 鈴木 正行 20,000株
			東京都中央区 石黒 正亨 14,000株
			横浜市鶴見区 近藤 淳行 10,000株
			宮城県大崎市 遠藤 智 5,000株

- (注) 1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した上で、株式会社SBI証券がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
- 2 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。
- 3 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- 4 売出価額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

2 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込単位	申込証拠金 (円)	申込受付 場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
未定 (注) 1、2 発行価格等決定日 の株式会社東京証券 取引所における 当社普通株式の普 通取引の終値(当 日に終値のない場 合は、その日に先 立つ直近日の終 値)に0.90~1.00 を乗じた価格(1 円未満端数切捨 て)を仮条件とし ます。	未定 (注) 1 2	自 平成30年 3月16日(金) 至 平成30年 3月19日(月) (注) 3	100株	1株につ き売出価 格と同一 の金額	右記金融 商品取引 業者の本 店及びそ の委託販 売先金融 商品取引 業者の本 店及び営 業所	東京都港区六本木 一丁目6番1号 株式会社SBI証券	(注) 4

(注) 1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状況を勘案した上で、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る1株当たりの売買代金)を決定いたします。

- 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <http://www.rs-tec.jp/>)(新聞等)で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
- 2 前記「1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 3 前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において決定される申込期間と同一とします。
- 4 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
なお、引受人の手取金は前記「第1 募集要項 3 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引受人の手取金と同一といたします。
金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名	引受株式数
株式会社SBI証券	398,000株

- 5 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
- 6 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。
- 7 申込証拠金には、利息をつけません。
- 8 株式の受渡期日は、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」における株式の受渡期日と同日とします。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

種類	売出数	売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	242,000株	1,846,944,000	東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券

(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が貸株人より242,000株を上限として借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <http://www.rs-tec.jp/>)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

2 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

3 売出価額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります

4 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

売出価格(円)	申込期間	申込単位	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
未定 (注)1	自 平成30年 3月16日(金) 至 平成30年 3月19日(月) (注)1	100株	1株につき 売出価格と 同一の金額	株式会社SBI証券の 本店及び営業所		

(注)1 売出価格及び申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

2 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

3 申込証拠金には、利息をつけません。

4 株式の受渡期日は、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」における株式の受渡期日と同日とします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、242,000株を上限として一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が貸株人から借り入れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、当社は、平成30年3月6日(火)開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資(本第三者割当増資)を行うことを決議しております。

株式会社SBI証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成30年4月13日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注))、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社SBI証券の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、株式会社SBI証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

株式会社SBI証券は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

株式会社SBI証券が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、株式会社SBI証券はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、株式会社SBI証券による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、株式会社SBI証券は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

(注) シンジケートカバー取引期間は、

発行価格等決定日が平成30年3月13日(火)の場合、「平成30年3月16日(金)から平成30年4月13日(金)までの間」

発行価格等決定日が平成30年3月14日(水)の場合、「平成30年3月19日(月)から平成30年4月13日(金)までの間」

発行価格等決定日が平成30年3月15日(木)の場合、「平成30年3月20日(火)から平成30年4月13日(金)までの間」

となります。

2 第三者割当増資について

前記「1 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の株式会社SBI証券を割当先とする本第三者割当増資について、当社が平成30年3月6日(火)開催の取締役会において決議した内容は、以下の通りです。

- (1) 募集株式の数は、当社普通株式242,000株とします。
- (2) 払込金額は、1株につき、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において決定される一般募集における発行価額(払込金額)と同一とします。
- (3) 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- (4) 払込期日は、平成30年4月18日(水)とします。

3 ロックアップについて

一般募集に関して、売出人である方永義、李宗根、本郷邦夫、鈴木正行、石黒正亨、近藤淳行及び遠藤智は、株式会社SBI証券に対して、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、株式会社SBI証券の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。

また、当社は株式会社SBI証券に対して、ロックアップ期間中は、株式会社SBI証券の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行等(ただし、一般募集、本第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨を合意しております。

なお、上記の場合において、株式会社SBI証券は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4 【その他の記載事項】

特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項は次の通りであります。

- ・表紙に当社のロゴマーク  を記載いたします。
- ・裏表紙に当社のロゴマーク  を記載いたします。
- ・表紙の次に「1 事業の概況」～「3 業績等の推移」をカラー印刷したものを記載いたします。

本ページ及びこれに続く図表等は、当社グループの概況等を要約・作成したものであります。
詳細は、本文の該当ページをご参照ください。

1 事業の概況

当社グループは、当社、台湾の艾爾斯半導體股份有限公司及び中国の北京有研RS半導体科技有限公司(それぞれ連結子会社)の3社により構成されております。

当社グループは「地球環境を大切に、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」という経営理念に基づき事業活動を展開しております。

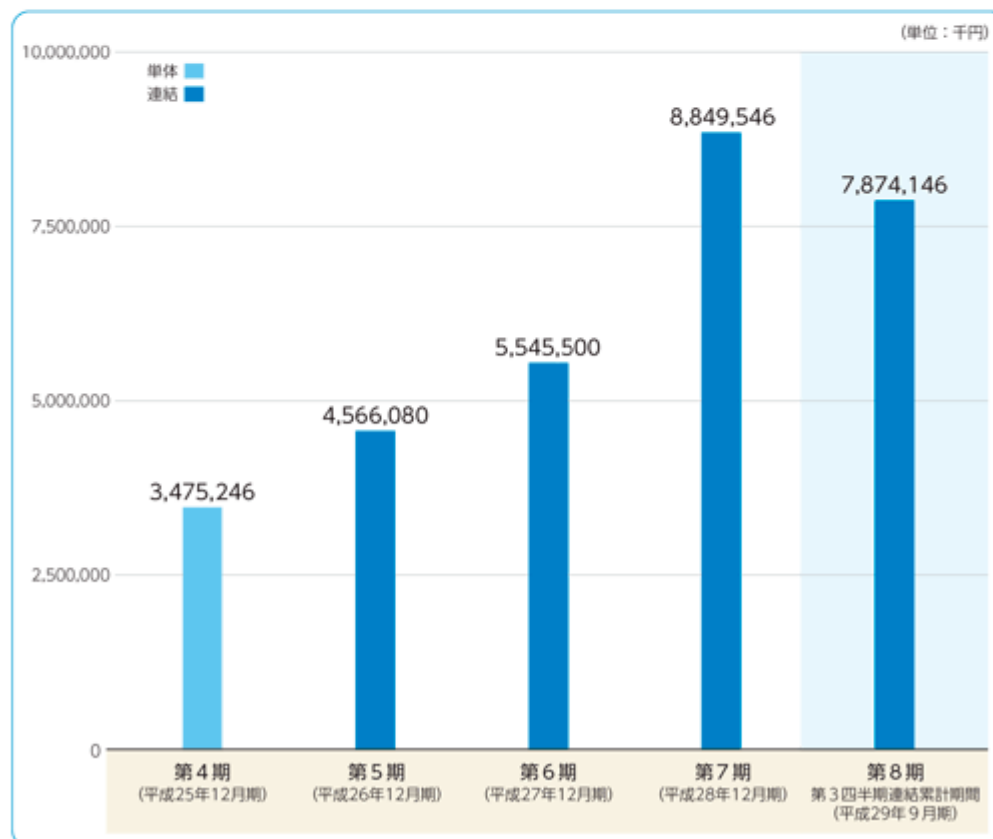
当社グループの主要な事業であるシリコンウェーハ再生事業は、ラサ工業株式会社が25年間世界の半導体製造会社にサービスを提供してきた事業を引き継いだものであり、半導体製造過程で発生するモニタウェーハ(※1)の再生を行う事業であります。シリコンウェーハの再生は、半導体製造工程の特徴及び製造コストの面から需要が発生するものであり、新興国の経済発展及び先進国の更なるデバイス用途(車・医療・環境・家・町・データセンター・IoT・M2M(※2))の広がり等を背景とした半導体需要の増加とともに需要が拡大しております。当社グループは、国内外の半導体製造会社を取引先とし、大手ファウンドリ(※3)を含めグローバルに販売活動を実施しております。また、シリコンウェーハ再生事業の他、ウェーハ事業として2018年1月に新設した北京有研RS半導体科技有限公司を通じて、有研半導体材料有限公司を連結化したことにより、新たにプライムシリコンウェーハ製造販売事業に参入しております。

※1 モニタウェーハ：半導体製造過程のモニタリングを実施するために使用するウェーハ

※2 M2M：Machine to Machine(マシン・ツー・マシン)の省略形で、機器間の通信を意味しております。

※3 ファウンドリ：半導体産業において、実際に半導体デバイス(半導体チップ)を生産する工場のことを指しております。

売上高構成



(注) 当社は、平成26年2月に子会社を設立した事に伴い第5期第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、第4期に係る売上高については単体のみ記載しております。

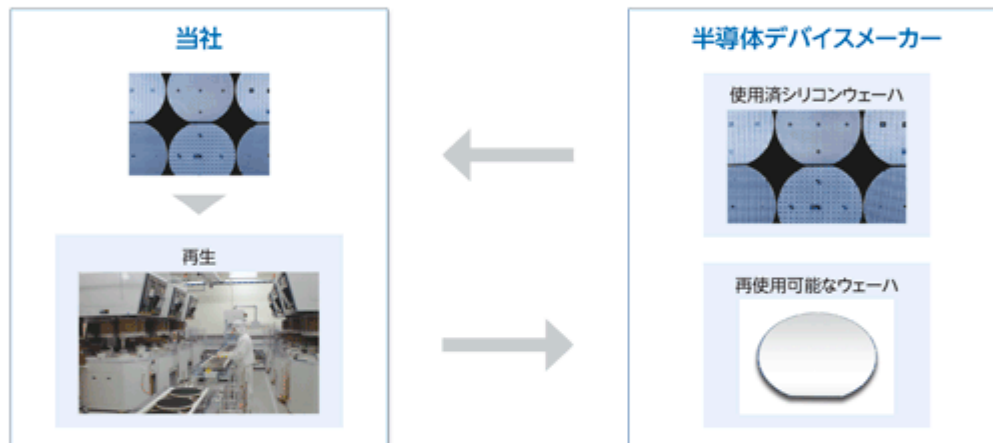
2 事業の内容

ウェーハ事業

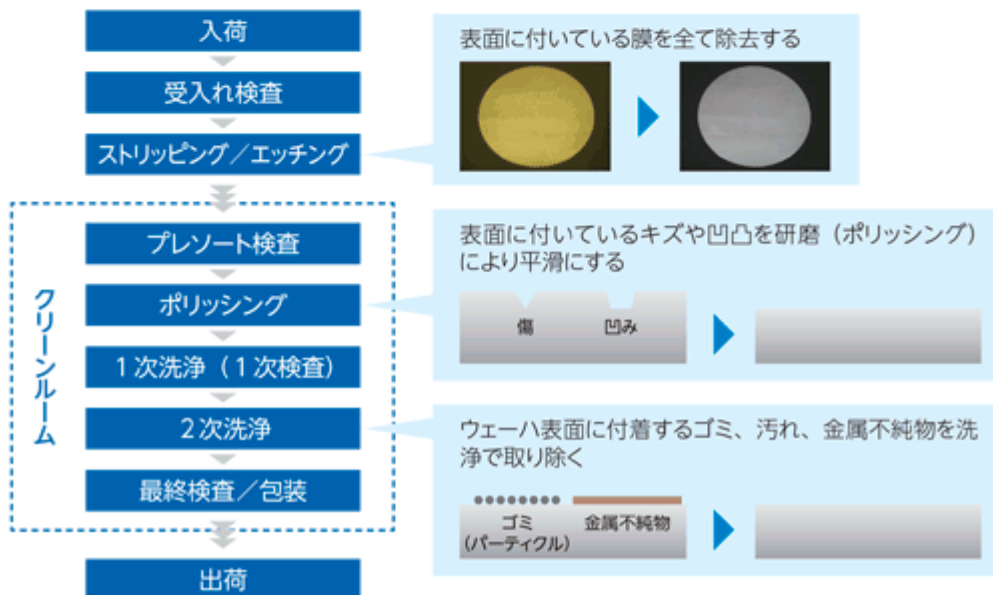
1. シリコンウェーハ再生事業

シリコンウェーハ再生事業は、半導体製造会社から使用済みのシリコンウェーハを預かって加工し、使用可能な状態にする事業です。加工は主に「ストリッピング・エッチング（ウェーハ表面膜の除去）」、「プレソート検査（中間検査）」、「ポリッシング（研磨）」、「1次洗浄」、「2次洗浄」、「最終検査」、という工程を経て実施されます。加工によりほぼ新品と同等の品質で再生できるため、いわばシリコンウェーハのクリーニング事業といえます。

当社グループのシリコンウェーハ再生事業のビジネスモデルを示すと下図のとおりであります。



工程概要



シリコンウェーハの再生は、半導体製造過程の以下のような特徴から需要が発生します。

すなわち、半導体製造会社において、半導体は数百もの工程を経て製造されていますが、数百ある工程のある一箇所で不良が生じ、そのまま最終工程まで加工した場合、不良品が発生することにより、多大な損害が生じる可能性があります。これを防止するため、各工程で加工状態をモニタリングする必要があります。そこで半導体製造会社は、製品用シリコンウェーハ（プライムウェーハ（※4））と同時にモニタ用シリコンウェーハ（モニタウェーハ）を工程に投入し加工しています。

プライムウェーハは最終工程でチップとしてカッティングされますが、モニタウェーハは各工程で抜き取りがされる為、円盤のまま形状が残ります。円盤形状を維持しているものの、加工済みのモニタウェーハには様々な情報が組み込まれているため、そのままの状態では工程へ再投入することはできず、破棄されることとなります。一方、1枚のモニタウェーハは10回から20回程度再生が可能であり、半導体製造会社にとっては、加工済みのモニタウェーハを再生加工することにより、新品のウェーハと同等品質のモニタウェーハを低コストで利用することができます。

※4 プライムウェーハ：カッティングされにチップとして製品化されるウェーハ

2. プライムシリコンウェーハ製造販売事業

当社グループの1社である北京有研RS半導体科技有限公司の子会社の有研半導体材料有限公司が製造及び販売を行う半導体用シリコンウェーハは、半導体メーカーが半導体を製造する上で基板材料として用いられるものであります。有研半導体材料有限公司は中国国内の半導体メーカーのニーズに合わせて主に125mm、150mm、200mmのシリコンウェーハを製造販売しております。

半導体生産設備の買取・販売事業

半導体生産設備の買取・販売事業は主に半導体関連機械装置や半導体関連の消耗材など各種半導体関連商品を中国をはじめとする東南アジア市場へ販売する事業であります。

事業拠点

当社グループでは、国内外に事業拠点を展開しております。



3 業績等の推移

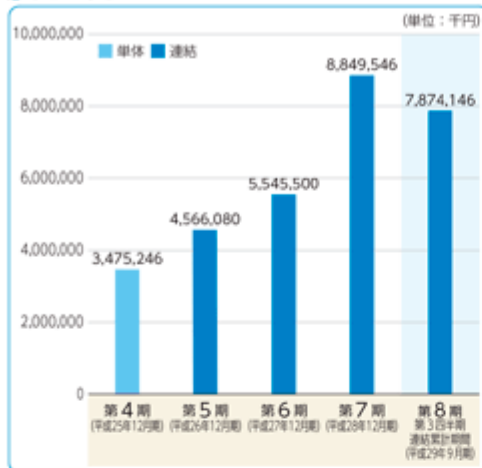
回数	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	
決算年月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年9月	
(1) 連結経営指標等						
売上高	(千円)	—	4,566,080	5,545,500	8,849,546	7,874,146
経常利益	(千円)	—	1,247,946	937,865	1,450,696	2,251,462
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益	(千円)	—	664,261	304,248	869,652	1,501,584
包括利益又は四半期包括利益	(千円)	—	694,437	284,848	862,624	1,528,885
純資産額	(千円)	—	1,596,094	2,644,121	3,541,290	5,041,353
総資産額	(千円)	—	6,823,640	9,737,737	10,859,200	11,362,062
1株当たり純資産額	(円)	—	300.54	485.54	321.30	—
1株当たり当期(四半期)純利益金額	(円)	—	131.90	56.72	79.98	135.62
潜在株式調整後1株当たり当期(四半期)純利益金額	(円)	—	—	55.04	77.57	129.65
自己資本比率	(%)	—	22.5	27.1	32.6	44.3
自己資本利益率	(%)	—	43.3	14.6	28.2	—
株価収益率	(倍)	—	—	37.7	25.1	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	—	643,351	470,273	964,180	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	—	△3,215,793	△2,127,740	△776,264	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	—	3,066,993	2,327,368	△91,211	—
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	—	951,027	1,603,704	1,714,252	—
従業員数	(名)	—	191	265	373	—
(ほか、平均臨時雇用人員)		(—)	(100)	(130)	(152)	(—)

- (注) 1. 第5期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 第5期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
4. 第5期の自己資本利益率は連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。
5. 第5期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
6. 従業員数は就業人員(当グループからグループ外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、年間平均人員を()に外数で記載しております。
7. 当社は、平成26年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますが、第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
8. 当社株式は、平成27年3月24日をもって、東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、第6期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から第6期までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
9. 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としてしております。
10. 平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期(四半期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期(四半期)純利益金額を算定しております。

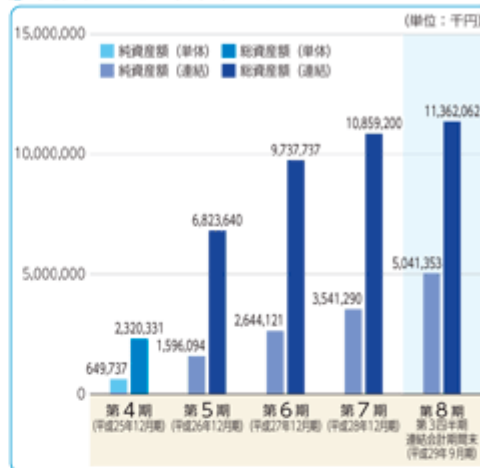
回数	第4期	第5期	第6期	第7期	
決算年月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	
(2) 提出会社の経営指標等					
売上高	(千円)	3,475,246	4,566,080	5,752,764	7,817,257
経常利益	(千円)	818,713	1,293,746	1,364,087	1,564,684
当期純利益	(千円)	524,796	710,074	801,151	920,759
資本金	(千円)	100,000	199,000	616,450	629,450
発行済株式総数	(株)	10,000	5,110,000	5,440,000	5,505,000
純資産額	(千円)	649,737	1,557,811	3,182,781	4,138,084
総資産額	(千円)	2,320,331	6,046,620	7,896,710	9,652,243
1株当たり純資産額	(円)	129.95	304.86	584.68	375.53
1株当たり配当額	(円)	—	—	—	5.00
(1株当たり中間配当額)	(円)	(—)	(—)	(—)	(—)
1株当たり当期純利益金額	(円)	104.96	141.00	149.35	84.68
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	(円)	—	—	144.92	82.13
自己資本比率	(%)	28.0	25.8	40.2	42.8
自己資本利益率	(%)	135.5	64.3	33.8	25.2
株価収益率	(倍)	—	—	14.3	23.7
配当性向	(%)	—	—	—	5.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	403,756	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△394,905	—	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	308,252	—	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	377,995	—	—	—
従業員数	(名)	152	181	192	206
(ほか、平均臨時雇用人員)		(99)	(100)	(130)	(141)

- (注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 第4期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 第5期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
4. 第4期及び第5期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
5. 第4期から第6期までの配当性向については、無配のため、記載しておりません。
6. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、年間平均人員を()に外数で記載しております。
7. 当社は、平成26年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行いました。第4期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
8. 第5期より連結財務諸表を作成しているため、第5期から第7期のキャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。
9. 平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり配当額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
10. 第7期の1株当たり配当額5円には、東証1部市場変更の記念配当2.5円を含んでおります。

売上高



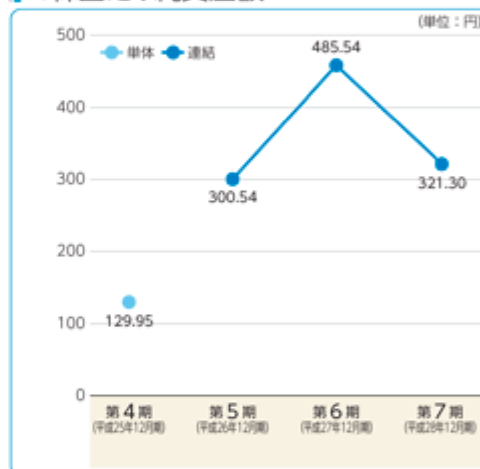
純資産額／総資産額



経常利益



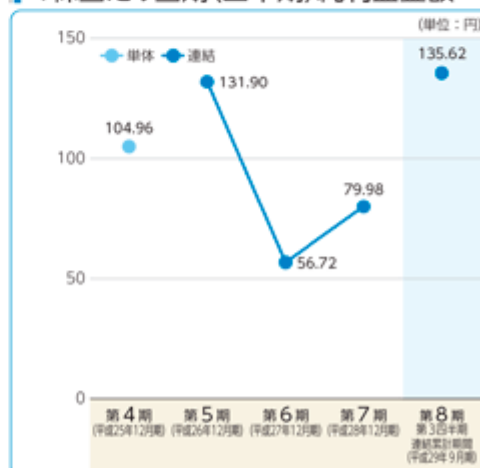
1株当たり純資産額



当期純利益又は親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益



1株当たり当期(四半期)純利益金額



- (注) 1. 当社は、平成26年9月9日付で株式1株につき500株の株式分割を行っております。上記「1株当たり純資産額」「1株当たり当期(四半期)純利益金額」の各グラフにおいては、当該株式分割に伴う影響を加味し、選及修正を行った場合の数値を表記しております。
2. 当社は、平成26年2月に子会社を設立した事に伴い第5期第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、第4期に係る主要な経営指標等の推移については単体のみ記載しております。
3. 当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記「1株当たり純資産額」「1株当たり当期(四半期)純利益金額」の各グラフにおいては、当該株式分割に伴う影響を加味し、選及修正を行った場合の数値を表記しております。

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

1 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <http://www.rs-tec.jp/>)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

2 募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1) 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」といいます。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(注1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(注2)の決済を行うことはできません。

(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家が行った空売り(注1)に係る有価証券の借入れ(注2)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。

(注) 1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。

- ・先物取引
- ・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除きます。)等の空売り
- ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

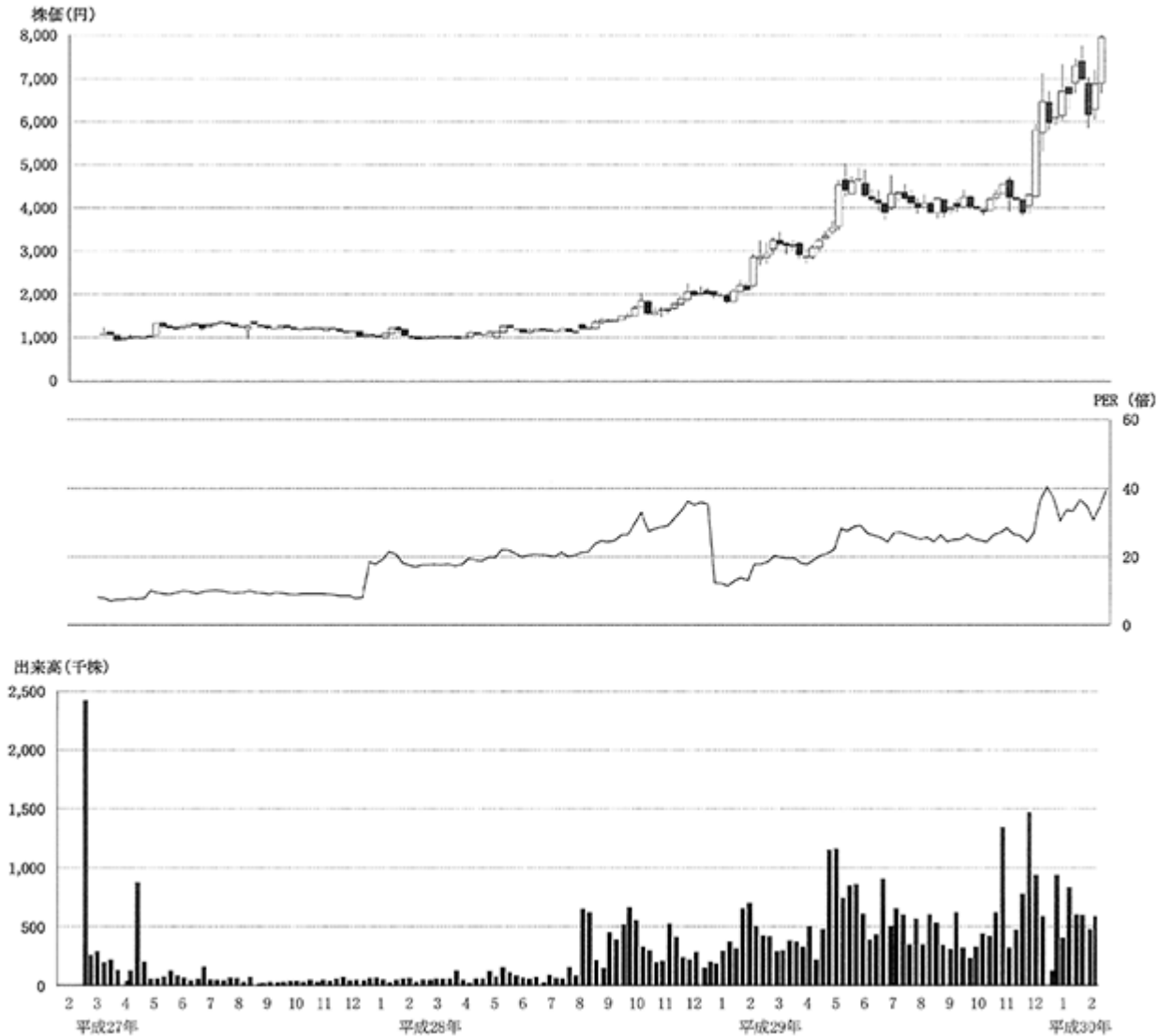
・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

(株価情報等)

1【株価、P E R 及び株式売買高の推移】

平成27年3月24日から平成30年2月23日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、P E R 及び株式売買高の推移(週単位)は以下の通りであります。

なお、当社株式は、平成27年3月24日をもって株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、それ以前の株価、P E R 及び株式売買高について、該当事項はありません。



- (注) 1 当社は平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、平成29年6月27日(株式分割前最終売買日)以前の株価、P E R 及び株式売買高の推移(週単位)については、下記(注)2及至4記載のとおり、当社株式分割を考慮したものとしております。
- 2
- ・ 株価のグラフ中の一本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。なお、平成29年7月1日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を2で除して得た数値を株価としております。
 - ・ 始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
 - ・ 終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

- 3 PERの算出は、以下の算式によります。

$$PER(倍) = \frac{\text{週末の終値}}{1 \text{株当たり当期純利益}}$$

平成27年3月24日から平成27年12月31日については、平成26年12月期有価証券報告書の平成26年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を2で除した数値を使用。

平成28年1月1日から平成28年12月31日については、平成27年12月期有価証券報告書の平成27年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を2で除した数値を使用。

平成29年1月1日から平成29年12月31日については、平成28年12月期有価証券報告書の平成28年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を2で除した数値を使用。

平成30年1月1日から平成30年2月23日については、平成30年2月13日に公表した平成29年12月期の未監査の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。

- 4 株式売買高については、平成29年7月1日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に2を乗じて得た数値を株式売買高としております。

2 【大量保有報告書等の提出状況】

平成29年8月27日から平成30年2月28日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、下記の通りであります。

提出者(大量保有者)の氏名又は名称	報告義務発生日	提出日	区分	保有株券等の総数(株)	株券等保有割合(%)
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社	平成29年8月28日	平成29年9月1日	大量保有報告書	587,400	5.28
RIHUI(Hong Kong)INVESTMENT TRADING CO.	平成28年10月12日	平成29年10月26日	訂正報告書(注1)	271,100	4.98
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社	平成29年12月11日	平成29年12月14日	変更報告書No. 1	723,100	6.49
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社	平成30年2月12日	平成30年2月15日	変更報告書No. 2	551,900	4.93

(注) 1 当該訂正報告書は、平成28年11月1日付で提出(報告義務発生日 平成28年10月12日)された変更報告書No. 1の記載内容の訂正のために提出されたものです。

- 2 上記の大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場している株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

第7期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年3月29日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】

第8期 第1四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年5月15日関東財務局長に提出

第8期 第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) 平成29年8月10日関東財務局長に提出

第8期 第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月14日関東財務局長に提出

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)までに、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出

(平成29年3月31日提出の臨時報告書)

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書

(平成29年12月21日提出の臨時報告書)

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された『事業等のリスク』及び『設備の新設、除却等の計画』について、以下のとおり、追加いたします。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

『事業等のリスク』

(1) M&A、事業提携に関するリスク

当社グループは、今後の業容拡大等においてM&A及び事業提携戦略は重要かつ有効であると認識しております。M&Aや事業提携を行う場合においては、対象会社を慎重に検討し、対象会社の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努める方針としておりますが、買収後に偶発債務の発生等、未認識の債務が判明する可能性も否定できません。また、のれんが発生する場合はその償却額を超過する収益力が安定的に確保できることを前提としておりますが、買収後の事業環境や競合状況の変化等により買収当初の事業計画遂行に支障が生じ、計画どおりに進まない場合は当該のれんに係る減損損失等の損失が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

『設備の新設、除却等の計画』

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		着手及び完了予定年月		完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)	着手	完了	
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約10%増
艾爾斯半導體股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約30%増
有研半導體材料有限公司	北京工場 (中華人民共和国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ製造設備	9,473,393		平成31年 1月	平成32年 1月	現状の約300%増

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 上記の表に関しては、当該有価証券報告書等に記載された『設備の新設、除却等の計画』の当社グループ全体の設備投資計画について記載したものです。なお、有研半導體材料有限公司北京工場への設備投資予定額9,473,393千円に関しては、中国の合併会社である北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円、今回の増資によって調達する2,800,000千円(当社の中国の合併会社への増資資金)および2,473,393千円(有研半導體材料有限公司北京工場8インチシリコンウェーハ製造設備投資資金)を充当する予定となっております。

なお、北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円につきましては、「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」の表にも記載の通り、借入金により賄ってりましたが、今回の増資資金により全額返済の予定であります。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社RS Technologies 本店

(東京都品川区大井一丁目47番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

該当事項はありません。